

株式会社東京精密 2021年度(2022年3月期) 決算説明会
質疑応答 要約

2022年5月10日 開催

1. 本資料は、上記日時に開催された2021年度(2022年3月期) 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
2. 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
3. なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」、ディスプレイドライバICを「DDIC」と表記します。

【質疑応答：2021年度業績説明、2022年度業績予想】

1. 会社は2022年度 SPEの受注に短期的な調整があると想定しているが、具体的な減速兆候の有無と、足許の製品別・アプリケーション別需要動向を伺いたい。
 - 全般には良い環境が続いているが、ダイサは数か月前から落ちてきている感覚がある。後工程装置需要は主にウェーハ・チップ数に依存する傾向があるが、テスト工程のプロバはテストの長時間化により好調を維持していると感じている。
 - 中国ロックダウンの影響、スマートフォン・PC市況の停滞などが伝えられている一方、量販店に赴いてもPCの店頭在庫が無い状況が続いている。これは前工程メーカーから後工程メーカーへのウェーハアウトプットが想定通りには増加していないことが要因であり、この結果、後工程メーカーの投資手控えに繋がっていると考える。
 - アプリケーション別でも全般に良い。特にパワー・SiC関連・ハイエンドロジック・イメージセンサなどが堅調。スマートフォン・PCの停滞で一部DDIC需要は下がっているようだが、車載用DDIC需要が増え、プロバに受注がある。
 - 研削装置は全般に堅調。特にシリコン用でポリッシュグラインダが好調。SiC用グラインダも同様で、かつCMPやエッジグラインダとセットの例が増加している。
2. 「中国ロックダウンにより売上高が社内計画比20億円下振れた」というのは2021年度4Qに起こった事か。
 - その通り。2022年3月後半に上海地域がロックダウンされ、同月案件のうち20億

円程度が出荷・立上・通関の停滞や、倉庫で留め置きの為、売上計上できなかった。

3. **2021年度4QのSPE営業利益実績について一過性となる要素はあるか。**
 - 従業員へ特別賞与を支給しており、全社で10億円弱。うち6億円程度がSPE経費増加に繋がっている。
4. **現在のSPE製品納期について聞きたい。**
 - プローバは、12インチ用で約10か月、8インチ用では12か月。ダイサは従前より短縮し5か月程度となっている。概して、欧米先端ロジック向けの発注は納入が1年先となっている。
5. **現在の部材調達状況・会社の対応策・解消時期の見通しなどを伺いたい。**
 - 両セグメントとも 調達が最も困難なのは半導体デバイスであり、以下 コネクタなど樹脂製品が続く。対応として、市場流通在庫の入手や、調達が容易なもので代替できるように電気基板の設計変更を行うことで凌いでいる。電気設計エンジニアは工数をかけ、相当な設計変更を行っている。
 - この状況は1年以上続くことを覚悟しておかなければならないと考えている。ただし、コネクタなど樹脂製品の逼迫は東南アジアのロックダウンが主因となっていたので、コロナ感染症が収束に向かえば改善すると考えるのが妥当。
6. **部材価格の上昇を製品価格へ転嫁する計画はあるか。**
 - SPEは競争が激しい業界でありなかなか難しい。
 - 計測では価格改定を検討しており、既に2022年度の業績予想に一部織り込んでいる。
7. **計測における充放電試験システム事業の現況を聞きたい。**
 - 受託評価ビジネスに力をいれており、同ビジネスは漸く利益が計上できる水準となった。
 - 新たな機器開発も進めており、2022年度中には市場投入し、こちらでも利益創出を狙いたい。
8. **2022年度の業績予想について、部材価格高騰(約20億円)以外の変動要素があれば聞きたい。また2021年度特別賞与は2022年度の経費減少要因と考えてよいか。**
 - 部材価格高騰以外では、物流コストの上昇、生産スペース確保のための外部倉庫借用費用などを想定している。
 - 特別賞与相当分の経費は減少するが、その他 為替前提による減益や研究開発

費・減価償却費・コロナ後を見据えた展示会費用(広告費)・旅費交通費などの増加を想定。

- 更に、2023年度稼働の飯能工場に関連した採用・社員寮関連費用や売上増加に伴う販売費用の増加を想定しており、これらが利益率に影響する。
- 以上から経費10億円、人件費10億円、販売費用10億円程度の増加を想定。

9. 為替感応度について、整理して説明いただきたい。

- 1ドル1円で80百万円/年の営業利益影響(円安が益)。
- 連結決算では会計期間末日のレートを適用。(3月末1ドル=約122円)
- 2022年度の業績予想の為替前提は1ドル=115円。
- なお、2022年度より、連結計算における換算レートを、期末レートから期中平均レートへ変更予定。

10. SPE 消耗品の現在の売上水準を確認したい。

- 2021年度は50億円程度となり、特に研削製品用の砥石の販売が伸びている。2022年度の消耗品売上高は70億円程度になると予想。
- エッジグラインダ消耗品は、現状1億円/月程度で、今後2億円/月程度へ増加すると想定する。
- SiCでは、砥石消費量も多いので消耗品売上の増加に繋がると期待。

11. 計測の、半導体関連業界に向けた受注動向と、今後の利益率の考え方を聞きたい。

- 計測の半導体関連受注は2021年3Qに増加し、その後4Qに減少した。これは補助金関連の案件の発注が3Qに集中した為で、2021年度下期全体では増加基調にある。2022年度以降も市場開拓・潜在顧客の増加に取り組む。
- 利益率に関して、2018年度の既往ピーク以降、事業買収・工場建設など成長に向けた投資を進める中で市況が悪化し、利益率が低下した。現在は市場も回復基調にあり、新中期経営目標で示す活動を通じ、利益率・利益額ともに既往ピークを越える水準にしたいと考える。

【質疑応答：2022年度-2024年度 中期経営計画】

12. 2022年度-2024年度 中期経営計画において業績けん引を期待する分野と、計画達成におけるリスクを確認したい。

- 売上目標1,700億円うちSPEが1320億円、計測380億円である。本日の説明で述べたように、半導体市場の爆発的な成長と、計測におけるEV化(バッテリー測定)、半導体市場、当社SPEとのシナジーなどを期待した数字となっている。

- リスクは、自然災害リスク、地政学リスクなど 様々存在するが、定量的に織り込むのは困難である。予想しえない水準のリスクが発生しない限りは達成できる水準と考えている。

13. 中期経営計画の前提となる、SPE 製品別 CAGR を示している。これは市場平均を超える成長を想定しているのか。現状のシェアを踏まえ、要素を聞きたい。更に、加工装置の CAGR をプローバより高く見積もっている理由を聞きたい。

- 消耗品：当社独自のダイシングブレードの開発と SiC 関連消耗品の大きな事業機会を期待した数字設定である。
- 加工装置：アブレーションダイサへの参入が前提となる。高剛性グラインダ (HRG) の SiC 向け需要拡大や、スラリーを用いない(環境負担の少ない)研削需要の拡大も期待している。
- プローバ： シングルチャックプローバで相応のシェアを有しているが、メモリ用のマルチチャックプローバで出遅れたことがある。相応にキャッチアップを進めてきたが、さらにシェアを高めたい。
- 加工装置の CAGR をプローバより高く見積もる背景は、特にダイサはプローバほどのシェアを有しておらず、アップサイドが大きいことと、アブレーションダイサへの参入による。

14. アブレーションダイサでは、具体的にどのような工程に取り組むのか？

- Low-k 膜の除去工程が市場として大きく、まずはここから取り組む。新たなアプリケーション・工程に進出する、という意味ではない。

15. 研削装置の消耗品について、売上拡大のための生産規模拡大や外部技術導入の考え方はどうか？

- 今後、想定以上に需要が伸びる場合は、生産規模の拡大を検討する。当面は、技術面より数量確保が優先となる。

16. 消耗品の戦略として「顧客ニーズにマッチした商品の開発」とあるが、具体的にはどのようなことか。

- ダイシングブレードは材料の構成によって性能が変化する。このノウハウを駆使し、顧客に最適なブレードを提案したいという意味である。

17. 中期経営計画では、計測機器で様々な分野への開拓を図るとある。これを踏まえると、計測機器本体だけでなく周辺技術へも対応してゆくとの理解となるが、正しいか。正しいとすると、研究開発費が増加するのか。

- NEV化により、寸法形状測定に加えて表面形状測定などの新規需要や、自動化ニーズ、更に非自動車分野など、幅広く対応していく所存。このため、計測セグメント全体で対応してゆく。
- 従って、今後 研究開発費の水準が切りあがることは十分想定される。採用による増員のほか、顧客の需要と優先度により柔軟に調整する体制で臨む。

18. クルマ 1 台あたりの計測需要は、ICE から EV への移行により どのように変わると推定しているか。

- 台当たりでの換算は難しいが、エンジン部品の測定需要は EV 化により縮小の懸念がある。一方で EV 化によりモータ、シャフト、ギア測定など、ワンランク上の高精度測定を求められる部品が増加する。さらに、静粛性が求められることから、従来の寸法・形状測定から表面形状測定へ変化する。こういった要因から、EV においても当社計測事業の機会は十分にあると考えている。

19. 中期経営計画において、次の工場投資を検討とあるが、日野工場はどうするのか。

- 日野工場は環境アセスメントを実施しているが、時間を要する為、様々なオプションを模索する。

20. 現在の人手不足による生産逼迫状況や・今後の採用などについて聞きたい。

- まず、現在の生産逼迫は人手不足よりも部材供給によるところが大きい。
- 現在は人財採用を増やしている。従前から、飯能工場を想定し高卒人財の採用を進めていた。更に、社員寮確保など、採用しやすい環境を整えてきた。
- また企業が収益を上げた際は、臨時賞与として従業員に報いるのが自然な形だろうと思っている。なお 2022 年度は、近年にない水準でベースアップを行った。

21. SPE における新興国競合メーカーへの対応方針を聞きたい。

- 中国競合企業は 2 ケタ社あることを確認済。現状 性能面では当社が優位だが、いずれキャッチアップされることを想定し、「計測事業をもった唯一の半導体製造装置メーカー」として、計測技術とのシナジーなどで差別化を図りたい。

22. SPE における事業機会について、会社が最も期待する分野を聞きたい。

- HPC など高精度ロジック半導体であろう。テストの長時間化や、ウェーハレベルでの吸熱を行いつつテストを行う、などの事業機会の拡大に期待したい。

以上